



Heatsink thermal paste grease, 3 g weight

TG-G3.0-01

- Keep your computer's CPU cool
- Practical syringe for easy application

Χαρακτηριστικά

- Thermal compound (grease) for heatsinks
- Helps the heat dissipation from a CPU, chipset or processor to a heatsink
- Excellent thermal impedance
- Perfect stability will not separate, run, migrate, or bleed
- Non capacitive or electrically conductive

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:
Χώρα προέλευσης
Barcode
Τελωνειακός κώδικας

100
0.041
6.72
180x120x15 mm
390x380x280 mm
CN
8716309083133
3402909000

Προδιαγραφές

Weight: 3.0 g
Color: gray
Thermal conductivity: > 4.5 W / mK
Thermal Impedance <0.205 ° C-in2 / W
Density: > 2.5
Evaporation: <0.001 %
Volatility: <0.005 %
The dielectric constant: > 5.1
Dissipation Factor: <0.005
Viscosity: 76 CPS
Thixotropic index: 310 ± 10 ° C
Operating Temperature: -50 ~ 240 ° C

Πιστοποιητικά

